



帛江科技股份有限公司

BO-JIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

PRODUCT SPECIFICATION (產品規格書)

BO-JIANG

PART NO.(圖號)	7869ES501BD000B	DATE (日期)	2009 / 10 / 26
--------------	-----------------	-----------	----------------

TITLE(產品名稱)	SMA PANEL RECEPT JACK		
-------------	-----------------------	--	--

MATERIAL AND FINISH(材質及表面處理)

DESCRIPTION(名稱)	MATERIAL(材質)	FINISH(表面處理)
Center Contact(中心導體)	BERYLLIUM COPPER	30 μ" GOLD
Insulator(絕緣體)	TEFLON	WHITE
Outer Contact(外導體)	BRASS	3 μ" GOLD
Others(其它)		

ELECTRICAL(電氣特性)

項目	測試條件	測試規格
Impedance(阻抗)	0 ~ 18 GHz	75 Ω
Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)(駐波比)	0 ~ 18 GHz	1.4 Max.
Dielectric Withstanding Voltage(絕緣耐電壓)	DC, time: 60sec	1000 Vrms Min.
Contact Resistance (導體阻抗)	Center Contact (中心導體)	DC 0.2V, 1A 6 mΩ Max.
	Outer Contact(外導體)	DC 0.2V, 1A 2 mΩ Max.
Insulation Resistance(絕緣阻抗)	DC 500V, time: 60sec	5000 MΩ Min.

MECHANICAL(機械特性)

項目	測試條件	測試規格
Force To Engage/Disengage(接合力/脫離力):	N/A	2 in-lbs. max.
Contact Retention(中心導體承受力):	60mm/min	6 lbs. min.

REMARKS(備註)

- Between BODY (NO.1) And LOCK RING (NO.5) Must Withstand A 6 lbs. Axial Force.
(軸向力測試)。



A	N/A			
Issue 版本	Revision 修改記錄	Approved 核准	Checked 審核	Drawn 製定